



基于微泵和 Cu-Cu 混合键合的玻璃芯基板倒装芯片

刘汉诚 中国台湾欣兴电子公司科学家

演讲人简介:

刘汉诚在半导体封装领域拥有 40 余年的研发与制造经验,发表了超过 535 篇同行评审论文(其中 385 篇为第一作者), 获得 52 项美国授权专利及申请(31 项为第一发明人), 并撰写了 24 部专业教材。他当选为 IEEE 院士、IMAPS 院士和 ASME 院士, 长期活跃于产业界、学术界及行业协会的会议与论坛, 致力于贡献专业见解、汲取新知并分享经验。